

〔招待講演〕 低電圧デバイスの高速・高密度実装の現状

- 一 微細化技術 (低電圧化・高集積化)によって、顕在化したハード (ボード) 設計の課題とその解決案 一

水尾 学†

†株式会社 エスケーエレクトロニクス

〒602-0955 京都市上京区東堀川一条上ル堅富田町 436-2

E-mail: †mmizuo@cb.sk-el.co.jp

あらし 高集積・大規模 LSI は低電圧化により実現され、その傾向は益々加速しています。(特に FPGA など) を利用したハードウェアの開発においても、そのパフォーマンスの実現に際しては、電源など多くの課題が表面化しています。今回はボード実装 開発においてのそれら課題とその対策について紹介します。